

出展のご案内

第55回 国際電子回路産業展 JPCA Show 2026

会期 2026.6.10(水)~12(金)

会場 東京ビッグサイト 東2ホール[2C-65]

オクノのエレクトロニクス向け最新技術

奥野製薬工業は、半導体後工程向けの表面処理・めっき薬品として、TORYZAシリーズをリリースしました。薬品だけでなく、装置に関してもあらゆるご要望にお応えします。さらに、半導体パッケージ基板向けの最適めっき添加剤を拡充。オクノは、半導体産業の発展を支える表面処理・めっき薬品と装置をトータルでご提案いたします。

妄想をカタチに。TORYZA

TOP 奥野製薬工業株式会社

www.okuno.co.jp



低温はんだ

衝撃に強い

その問題、低温・鉛フリーはんだの新合金が解消します!

TempSave® B37

削減製品

LEAD FREE 鉛フリー solder パステット
SOLDER PASTE
TempSave B37 P610 D4

Lot No. : ABC-012345678
NET : 500g
F : 12%
製造日 : 2026/01/10
使用期限 : 2026/07/10

熱による反りを防ぐ

消費電力削減

- ☑ 低温はんだは強度が不安
- ☑ 基板の反りを抑えたい
- ☑ 部品の熱負荷を減らしたい
- ☑ 実装電力を削減したい
- ☑ 資材コストを下げたい

組成の改良により耐衝撃性を向上。200℃以下で実装可能です(融点 139 ~ 174℃)

株式会社 日本スペリア社 (TempSave は日本スペリア社の登録商標です)

www.nihonsuperior.co.jp

秋田市江坂町1丁目16番15号 NSビル(本社) ☎ 06(6380)1121 / (お問合せ) ☎ 06(6151)2735

電子機器トータルソリューション展 & Smart Sensing

「電子機器トータルソリューション展 2026」

講演会・シンポジウム・セミナー(一部)

電子機器トータルソリューション展 基調講演【無料・事前登録制】		
6/10(水) 11:30-12:20	AI時代を支えるフラッシュメモリ戦略と次世代製造	キオクシア岩手 社長 柴山耕一郎氏
6/11(木) 10:30-11:20	通信と情報処理に変革をもたらす IOWN構想とそれを支える光電融合デバイス技術	NTT先端集積デバイス研究所 所長 竹ノ内弘和氏
半導体産業展 特別講演【無料・事前登録制】		
6/11(木) 14:20-15:10	半導体の世紀	東京大学 特別教授 黒田忠広氏
6/12(金) 13:00-13:50	九州半導体の現在地と産業界(SIIQ)の取り組み	九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長 山口宜洋氏
JISSO PROTEC 特別講演【無料・事前登録制】		
6/10(水) 10:30-11:20	スマートフォン・周辺機器、Apple製品、AIサーバー業界見通し	みずほ証券 シニアアナリスト 中根康夫氏
PROTECセミナー【無料・事前登録不要】		
6/10(水) 12:55-13:40	自律生産の実現を目指す FUJI Smart Factoryの進化	FUJI スマートファクトリー開発部長 加藤大輔氏
出展者(NPI)プレゼンテーション【無料・事前登録不要】		
6/11(木) 12:15-12:35	ガラスへの高密着無電解銅シード形成プロセス	奥野製薬工業
3D-MID パビリオンセミナー【無料・事前登録不要】		
6/11(木) 11:00-11:30	アディティブマニュファクチャリングエレクトロニクス技術(AME Tech)	FUJI 開発センター 技術部長 富永亮二郎氏

JPCA Show

JPCA主催の「JPCA Show 2026」は、プリント配線板技術や半導体パッケージング、部品内蔵技術など4つの主要テーマで展示。フレキシブルプリント配線基板(FPC)や銅張積層板(CCL)といった製品・材料をはじめ、設計支援ツールや検査・製造装置などを紹介する。そのほか、め

「電子機器トータルソリューション展 2026」は、電子回路や電子部品、半導体デバイスや電子部品の組み合わせを促進するソリューションなど、エレクトロニクス産業に関わる最先端技術とサービスを発信する。入場料は1000円。ウェブでの事前登録者は無料。「Smart Sensing 2026」は入場無料(事前登録制)。

電子基板 | 設計・製造

「電子機器トータルソリューション展 2026」は、「テクノロジ」の中心をもち、国内外10社・団体が出展し、うち海外からは中国、台湾、韓国、インドなどの70社・団体が出展する。来場者は5万人を見込む。同展は「JPCA Show 2026(第55回国際電子工業展)」が務める。

「電子機器トータルソリューション展 2026」は、電子回路や電子部品、半導体デバイスや電子部品の組み合わせを促進するソリューションなど、エレクトロニクス産業に関わる最先端技術とサービスを発信する。入場料は1000円。ウェブでの事前登録者は無料。「Smart Sensing 2026」は入場無料(事前登録制)。

あす開幕

東京ビッグサイト



「電子機器トータルソリューション展 2026」と「Smart Sensing 2026」の2つの展示会が、10日から12日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開かれる。いずれも開催時間は10時~17時。電子回路や電子部品、半導体デバイスや電子部品の組み合わせを促進するソリューションなど、エレクトロニクス産業に関わる最先端技術とサービスを発信する。入場料は1000円。ウェブでの事前登録者は無料。「Smart Sensing 2026」は入場無料(事前登録制)。

センサー・ウェアラブル集結

「電子機器トータルソリューション展 2026」と「Smart Sensing 2026」の2つの展示会が、10日から12日までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開かれる。いずれも開催時間は10時~17時。電子回路や電子部品、半導体デバイスや電子部品の組み合わせを促進するソリューションなど、エレクトロニクス産業に関わる最先端技術とサービスを発信する。入場料は1000円。ウェブでの事前登録者は無料。「Smart Sensing 2026」は入場無料(事前登録制)。

Target ZERO

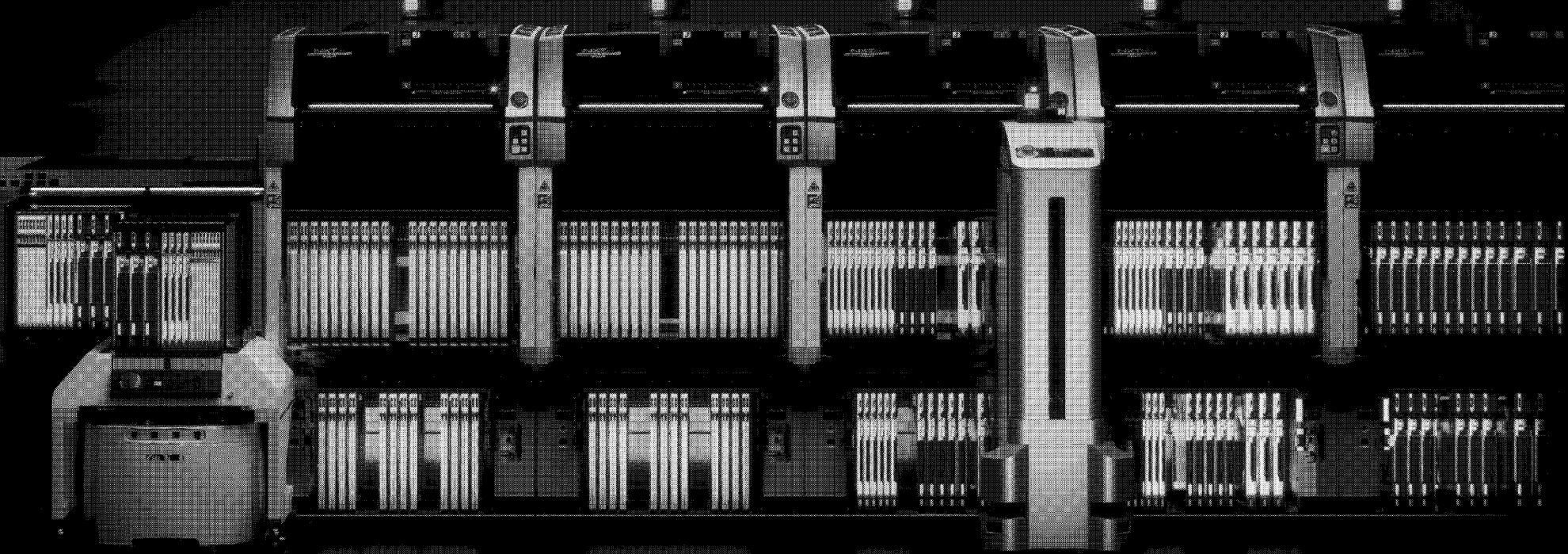
お客様とFUJIで共創する「最高品質」の生産現場

016
008
ZERO
Placement
Limits
実装限界ゼロ

ZERO
Placement
Defects
実装不良ゼロ

ZERO
Machine
Operators
オペレーターゼロ

ZERO
Machine
Stops
機械停止ゼロ



JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展
東1ホール 1A-46

https://smt.fuji.co.jp/targetzero/



https://smt.fuji.co.jp/targetzero/

洗う といえば 化研テック

- フラックス洗浄
 - ペースト・樹脂洗浄
 - パーティクル洗浄
 - 脱脂洗浄 など
- 実装工程の各種洗浄システムを開発・製造しています。

実装プロセステクノロジー展に出展! <東1ホール 1A-02>

Electronics Component & Unit Show

テーマ1 『開発から完成まで』の“スマート化”をカタチに!

テーマ2 『設計』と『現場』の“新しいスタンダード”をココから!

小間番号 1B-33
ご来場お待ちしております



100 東亜無線電機株式会社

Electronics Component & Unit Show

「Electronics Component & Unit Show」は、JEPは関東甲信越、東京、中部、近畿、中国、四国、九州の全国6団体からなる電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。EP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

半導体・電子デバイス

「電子機器」を埋め込む「電子デバイス」は、電子機器の機能を支える半導体、電子部品が集まる展示会。全国電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

そのほかの展示会

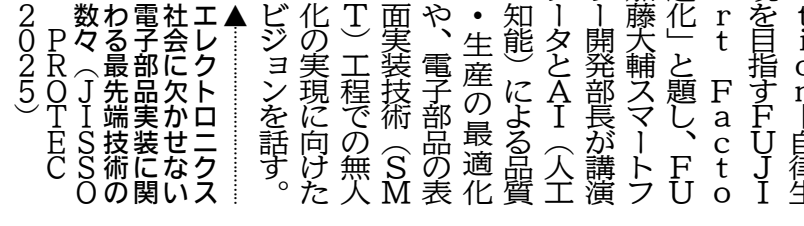
「電子機器」を埋め込む「電子デバイス」は、電子機器の機能を支える半導体、電子部品が集まる展示会。全国電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

新設の半導体関連2展示会

「電子機器」を埋め込む「電子デバイス」は、電子機器の機能を支える半導体、電子部品が集まる展示会。全国電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

JISSO PROTEC

JISSO PROTECは、電子部品業界の共通の課題を解決する最新の技術と材料を提供しています。また、最新の技術と材料を提供しています。また、最新の技術と材料を提供しています。



部品実装技術・材料

「電子機器」を埋め込む「電子デバイス」は、電子機器の機能を支える半導体、電子部品が集まる展示会。全国電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

マイクロエレクトロニクスショー

「電子機器」を埋め込む「電子デバイス」は、電子機器の機能を支える半導体、電子部品が集まる展示会。全国電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

電子回路・パッケージング

「電子機器」を埋め込む「電子デバイス」は、電子機器の機能を支える半導体、電子部品が集まる展示会。全国電子部品流通連合会(JEP)と東京都連合会、各地の電子部品と電機卸売商業協同組合(TEP)、JPCAが共催。アル電子、飯田通商、岡本無線電機、東亜無線電機の発展を目指す。

電子機器 トータルソリューション展 2026

出展企業の製品・技術 順不同

JPCA Show

奥野製薬工業

奥野製薬工業は次世代半導体パッケージ用の無電解銅めっきプロセスを紹介する。微細配線形成に適した無電解銅めっきプロセスに加え、有機バインダー層と真空紫外線(VUV)装置による親水処理を併用する。

ことで、高い平滑性と密着性を両立。高アスペクト比に対応すべく実用化を目指す。ガラスへの高密着めっきプロセス「TORIZINGプロセス」と、ガラスコーティング向けスルーホールフィリング硫酸銅めっき添加剤「トッブルチナGCSシリーズ」でめっき加工したガラス基板も展示する。

興研

興研のブースでは、低消費電力でISOクラス1の清浄空間を形成できる「オープンクリーンシステムKOACH(コーチ)」を紹介する。コンパクトな卓上型の「テーブルコーチ」や衝立型の「スタンドコーチ」に加え、大型ルームタイプの「フローコーチ」の実機を展示する。

さらに0.1μm対応のパーティクルカウンターと清浄度モニタリングシステムによる測定環境のもと、ISOクラス1のスーパークリーン空間を形成する様子を実演。画期的なクリーン環境を体感できる場を提供する。

JCU

JCUは強みである配線形成に必要な銅めっき、エッチング薬品を中心に、SAP・MSAPI法などに最適なプロセスを提案する。会場では半導体パッケージ基板用プロセスとして、

高面均性ピアフィリングめっきプロセス「CU-BRITE VF8」のほか、銅シード層向けにSAP用回路形成エッチングプロセス「NEZARK SAC 6・7・9」を展示する。さらにTi(チタン)シード層向けに新技術のSAP用Tiシード層エッチングプロセスなども紹介する。

JISSO PROTEC

日本スペリア社

日本スペリア社は最新の実装ニーズに応える接合材を提供している。新製品の鉛フリーハンダ「SN97C P613 D5/6/7」は、高速ジェット印刷に対応したディスペンサータイプ。

粉末サイズは三つのタイプを用意。高速吐出しても形状を維持し、最適で安定したハンダ付けを可能とする。また焼結型銀ペースト「アルコナノ銀ペースト」に、パワーデバイス向けの新製品「ASTROシリーズ」がラインアップに加わった。

FUJI

FUJIは自動化と生産性向上の高度化を実現する最新ソリューションを提案する。実装機「NXTR(ネクストアール)Aモデル」「同Sモデル」「AIMEXR(エイメックスアール)」を披露する。加え

て、新ラインアップのコンパクト汎用機「CLT-FG」やフィーダーへのテーブルルックアップを自動化する新ユニット「オートキッティングステーション」を初公開する。さらに、進化し続ける統合生産システム「Nexim」の新機能もデモンストレーションで紹介する。

化研テック

化研テックは有機フッ素化合物(PFAS)フリーのパーティクル(微粒子)除去システム「マイクロクリーナーFPS」を展示する。電子デバイスの高度化に伴いニーズが増す高い除去性能と環境負荷の低減を

両立した。また専用洗浄剤「マイクロクリンFPS」は、人由来の有機異物や微小異物に対して極めて高い除去性能を持つ。低揮発性有機化合物(VOC)・PFASフリーを実現し、水リンスが不要で排水のゼロ化にもつながる。清浄度を維持しながら洗浄からリンスまで一液で対応する。

Electronics Component&Unit Show

東亜無線電機

設立75周年の東亜無線電機は「スマート化」と「新しいスタンダード」を掲げ未来の製造革新を後押しする。基板実装の設計・開発から量産までを一貫対応するワンストップソリューションを出展。また金型や金属

部品の製作・加工事例や、既存設備を生かす後付けIoTでの電力監視も紹介する。そのほか液冷冷却対応コンデンサーや高温対応基板、AI搭載モジュール、現場帳票電子化、AI-OCR(人工知能による光学式文字読み取り装置)など、設計と現場の新常識となる技術を披露する。

半導体・電子部品業界などさまざまな分野で KOACHが次々に採用されています

クリーンルーム革命の KOACHから生まれた 超常識 が広がっています

来場者数 6千人突破! KOACH ショールームを見学しませんか [リモート見学可]

要予約 詳細はKOACHホームページから

会期中はセンサーやAI、半導体などをテーマとした講演とセミナーを開催する（聴講無料、事前登録制）。10日は横浜国立大学半導体量子集積エレクトロニクス研究センターの井上史大教授が「次世代AIを支える半導体後工程ソリューションの現在地と未来」と題して基調講演する。12日は日本政策投資銀行設備投資研究所の青木崇主任研究員が「CES2026と経済安全保障」と題し、米ラスベガスで1月に開催されたテクノロジー見本市「CES2026」の調査報告を行う。

センサー技術に特化／国内56社・団体出展



最新のセンサー技術が一堂に会する（JTBコミュニケーションデザイン提供）

出展企業の製品・技術

コーデンシ

コーデンシは光半導体技術を基礎に測距センサー、フォトインタラプター、光検知センサーをコア技術として確立しており、これらをもとにした光学式エンコーダーやサーモパイル、ほこりセンサー、光源用LEDなど、豊富なラインアップを取りそろえる。

光センサーは種類が豊富で一般的などのセンサーを使用すれば良いか判断が難しい。同社は光センサーの導入を検討しているユーザーの相談も受け付けている。

光のように

KODENSHI

Sensing Technology

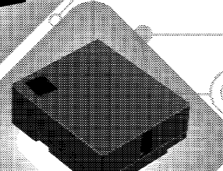
空気、距離、位置、回転等のセンシング！



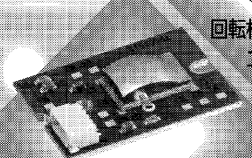
測距センサ



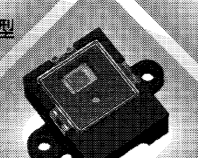
回転検知小型反射型エンコーダ



ほこりセンサ



フラットタイプサーモパイル温度センサ



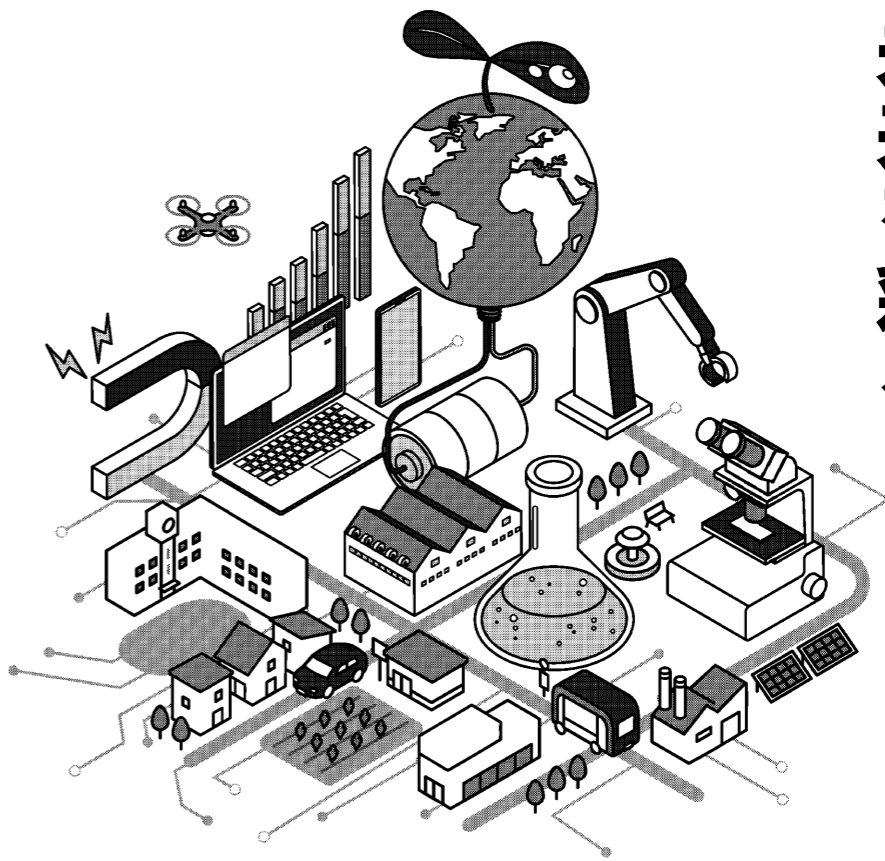
カラーセンサ

コーデンシ株式会社

〒611-0041
京都府宇治市横島町十一の161
TEL.0774-20-3559

Smart Sensing 2026 に出展します

2025 6/10 水▶12金 東京ビッグサイト 西3ホール A-02



「表面」の進化が 未来を彩る。

表面処理技術から未来を創造する

Explorer in Surface Engineering

私たちは、創業以来、装飾・防錆めっき技術から発展した様々な表面処理技術の提供で、自動車、エレクトロニクスなどの産業の成長を支えてきました。これからも、長年培った知見と研究・開発力で、新たな表面処理技術を追及し、ものづくりを支え、世界中の人々の豊かな生活に貢献します。

株式会社 JCU
<https://www.jcu-i.com/>

本社：〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 16階 TEL：03-6895-7001 FAX：03-6895-7021
国内拠点：本社 大阪支店 九州営業所 名古屋支店 総合研究所 生産本部 熊本事業所
海外拠点：中国 台湾 韓国 メキシコ ベトナム タイ インドネシア インド マレーシア